

LMH1208 12G UHD-SDI対応のデュアル出力ケーブル・ドライバ

1 特長

- ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD)、ST-259 (SD)をサポート
- DVB-ASIおよびAES10 (MADI)と互換
- デュアル差動出力ケーブル・ドライバ
- オンチップの75Ωターミネーションおよび復帰損失補償ネットワーク
- ホスト側の平衡化された100Ωループバック出力
- 75Ω出力のスルー・レートをプログラム可能
- 75Ω出力でのプリエンファシスおよび出力振幅をプログラム可能
- 100Ω出力でのディエンファシスおよび出力振幅をプログラム可能
- 75Ωおよび100Ω出力での極性反転
- 入力信号が存在しない場合の自動パワー・セーブ
 - 消費電力: 25mW (標準値)
- ENABLEピンによるパワー・ダウン制御
- 2.5V単一電源
 - 消費電力: 200mW (標準値)
- ピン、SPI、SMBusインターフェイスによりプログラム可能
- 40°C～+85°Cの動作温度範囲
- 5mmx5mm、32ピンのWQFNパッケージ

2 アプリケーション

- SMpte互換のシリアル・デジタル・インターフェイス
- UHDTV/4K/8K/HDTV/SDTVビデオ
- 放送用ビデオ・ルーター、スイッチャ、分配アンプ、モニタ
- デジタル・ビデオ処理および編集

3 概要

LMH1208デバイスは、12G UHD-SDI低消費電力、デュアル出力ケーブル・ドライバです。最大11.88GbpsのSMpteビデオ・レートをサポートし、4K/8Kアプリケーション用のUHDビデオに対応します。ホスト側には追加の平衡化された100Ωドライバ出力があり、監視や信号の分配目的に使用できます。

プログラム可能なPCB入力イコライザは、高周波の昇圧を行い、PCB基板の配線により発生する符号間干渉(ISI)を低減します。両方のケーブル・ドライバ出力には、75Ωターミネーションと、復帰損失ネットワークが搭載されており、システム全体の設計を厳格なSMpte復帰損失要件に合致させるために役立ちます。

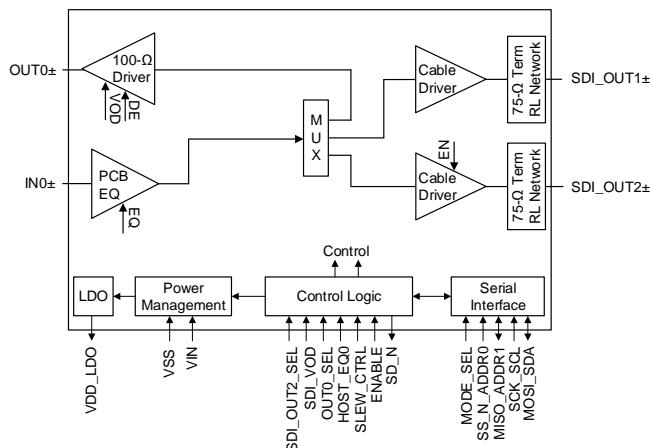
入力信号検出により、ケーブル・ドライバの入力に有効な信号が存在することを判定できます。このセンシング機能を使用して、システム・フォルトをユーザーに通知したり、パワー・セーブ・モードを有効にしてケーブル・ドライバの消費電力を減らしたりできます。LMH1208は、11.88Gbpsまでのデータ・レートに合わせてスルー・レートを選択可能です。出力のスルー・レートと振幅は、ピン、SPI、SMBusにより制御可能です。

製品情報⁽¹⁾

型番	パッケージ	本体サイズ(公称)
LMH1208	WQFN (32)	5.00mm×5.00mm

(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

ブロック概略図



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated



英語版のTI製品についての情報を翻訳したこの資料は、製品の概要を確認する目的で便宜的に提供しているものです。該当する正式な英語版の最新情報は、www.ti.comで閲覧でき、その内容が常に優先されます。TIでは翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、必ず最新版の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

English Data Sheet: SNLS576

目次

1 特長	1	6.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	4
2 アプリケーション	1	6.3 コミュニティ・リソース	4
3 概要	1	6.4 商標	4
4 改訂履歴.....	2	6.5 静電気放電に関する注意事項	4
5 概要(続き)	3	6.6 輸出管理に関する注意事項	4
6 デバイスおよびドキュメントのサポート	4	6.7 Glossary	4
6.1 ドキュメントのサポート	4	7 メカニカル、パッケージ、および注文情報	4

4 改訂履歴

2017年3月発行のものから更新

Page

- | | |
|---|---|
| • 特性データの更新に基づいて、標準消費電力を255mWから200mWに 変更 | 1 |
| • 「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションにパッケージの図を追加 | 4 |

5 概要（続き）

LMH1208は単一の2.5V電源で動作します。このデバイスは、占有面積の小さい5mm×5mm、32ピンのWQFNパッケージで供給されます。LMH1208は、LMH1228(リクロックを統合した12Gのデュアル・ケーブル・ドライバ)とピン互換です。

6 デバイスおよびドキュメントのサポート

6.1 ドキュメントのサポート

6.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

[『QFN/SONのPCB実装』アプリケーション・レポート\(SLUA271\)](#)

6.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の隅にある「通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

6.3 コミュニティ・リソース

The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's [Terms of Use](#).

TI E2E™オンライン・コミュニティ [TIのE2E \(Engineer-to-Engineer \) コミュニティ](#)。エンジニア間の共同作業を促進するために開設されたものです。e2e.ti.comでは、他のエンジニアに質問し、知識を共有し、アイディアを検討して、問題解決に役立てることができます。

設計サポート [TIの設計サポート](#) 役に立つE2Eフォーラムや、設計サポート・ツールをすばやく見つけることができます。技術サポート用の連絡先情報も参照できます。

6.4 商標

E2E is a trademark of Texas Instruments.

All other trademarks are the property of their respective owners.

6.5 静電気放電に関する注意事項

すべての集積回路は、適切なESD保護方法を用いて、取扱いと保存を行うようにして下さい。

 静電気放電はわずかな性能の低下から完全なデバイスの故障に至るまで、様々な損傷を与えます。高精度の集積回路は、損傷に対して敏感であり、極めてわずかなパラメータの変化により、デバイスに規定された仕様に適合しなくなる場合があります。

6.6 輸出管理に関する注意事項

受取人は、直接または間接に、ソフトウェアを含む(米国、英国およびその他の輸出管理規制で定められた)任意の製品または技術データ、他に適用される国による規制で制限されこの契約に基づいて開示者から受領した管理対象製品、または当該のテクノロジーの直接の産物について、米国法またはその他に適用される法律で当該の輸出または再輸出が制限または禁止されている仕向地に、当該の法律によって必要とされている範囲について米国商務省および権限を有するその他の政府機関による事前の許可を受けることなく、故意に輸出または再輸出しないことに合意します。

6.7 Glossary

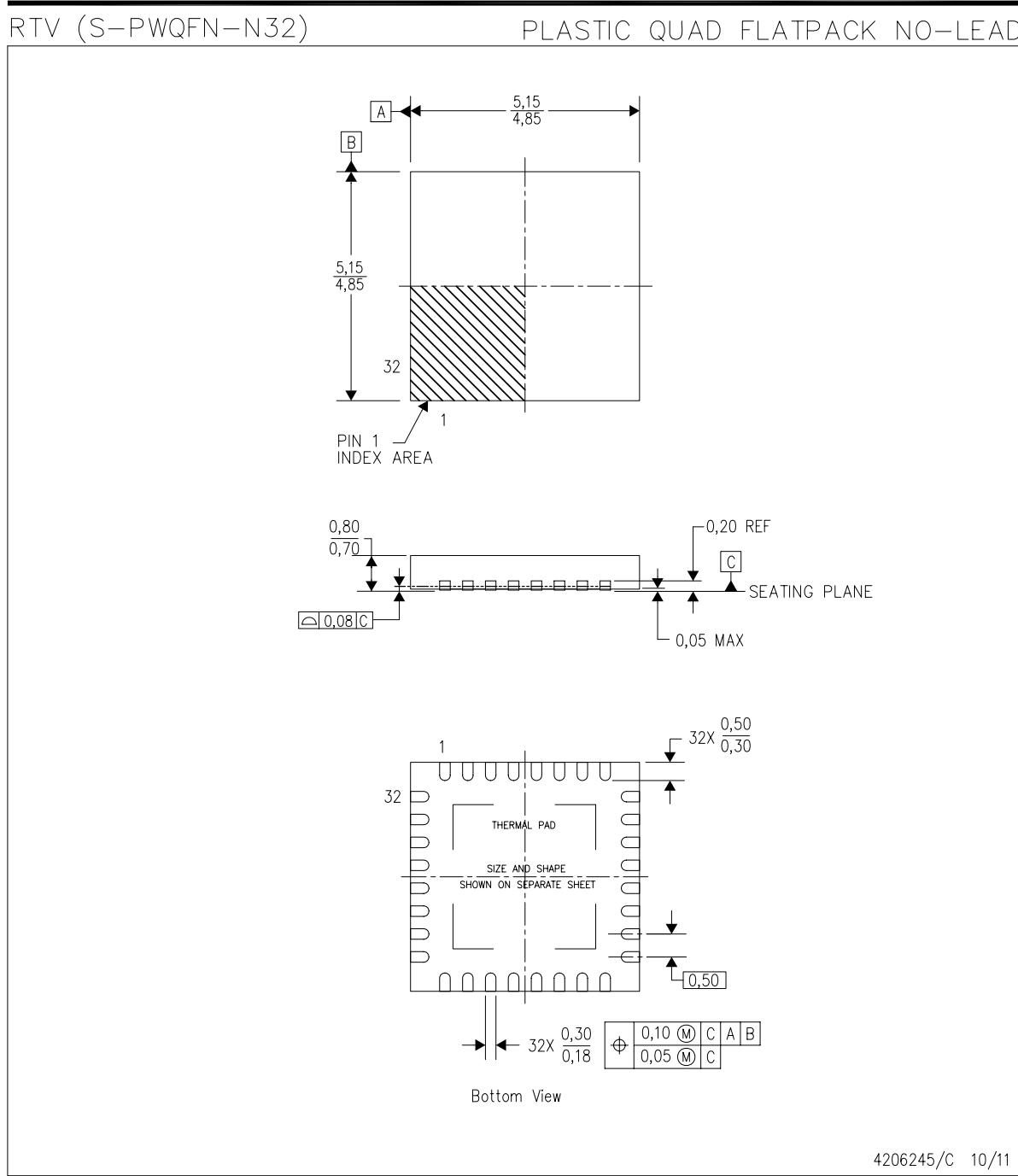
[SLYZ022 — TI Glossary](#).

This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.

7 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、そのデバイスについて利用可能な最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあります、ドキュメントが改訂される場合もあります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

MECHANICAL DATA



NOTES:

- A. All linear dimensions are in millimeters. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5-1994.
- B. This drawing is subject to change without notice.
- C. Quad Flatpack, No-Leads (QFN) package configuration.
- D. The package thermal pad must be soldered to the board for thermal and mechanical performance.
- E. See the additional figure in the Product Data Sheet for details regarding the exposed thermal pad features and dimensions.
- F. Falls within JEDEC MO-220.

THERMAL PAD MECHANICAL DATA

RTV (S-PWQFN-N32)

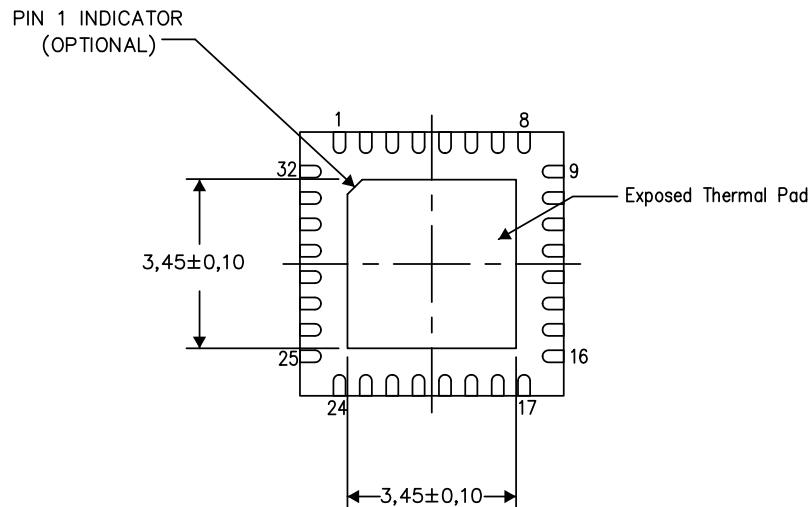
PLASTIC QUAD FLATPACK NO-LEAD

THERMAL INFORMATION

This package incorporates an exposed thermal pad that is designed to be attached directly to an external heatsink. The thermal pad must be soldered directly to the printed circuit board (PCB). After soldering, the PCB can be used as a heatsink. In addition, through the use of thermal vias, the thermal pad can be attached directly to the appropriate copper plane shown in the electrical schematic for the device, or alternatively, can be attached to a special heatsink structure designed into the PCB. This design optimizes the heat transfer from the integrated circuit (IC).

For information on the Quad Flatpack No-Lead (QFN) package and its advantages, refer to Application Report, QFN/SON PCB Attachment, Texas Instruments Literature No. SLUA271. This document is available at www.ti.com.

The exposed thermal pad dimensions for this package are shown in the following illustration.



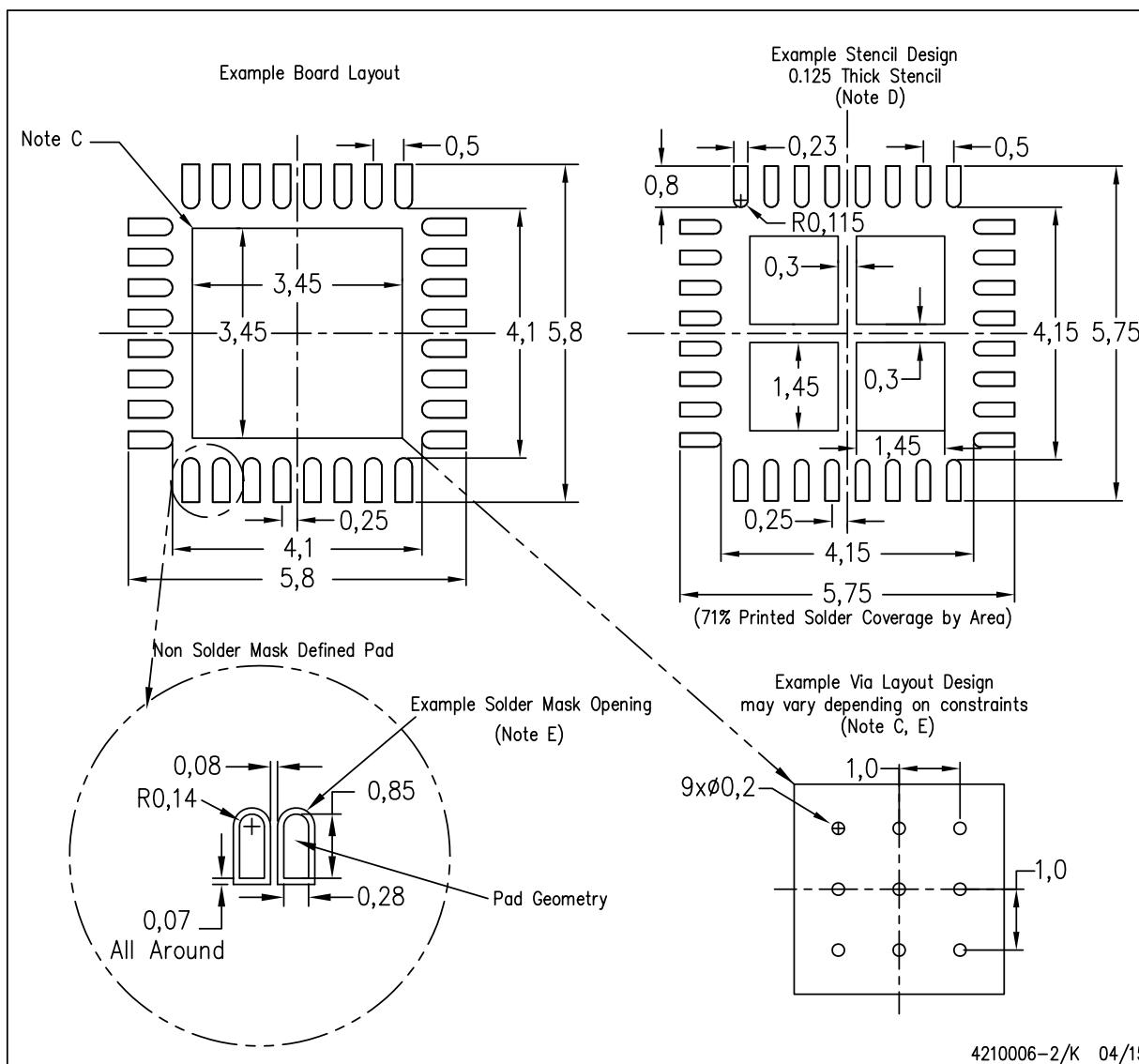
Bottom View

Exposed Thermal Pad Dimensions

4206250-2/Q 05/15

NOTE: All linear dimensions are in millimeters

LAND PATTERN DATA

RTV (S-PWQFN-N32)
PLASTIC QUAD FLATPACK NO-LEAD


- NOTES:**
- All linear dimensions are in millimeters.
 - This drawing is subject to change without notice.
 - This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. Refer to Application Note, Quad Flat-Pack Packages, Texas Instruments Literature No. SCBA017, SLUA271, and also the Product Data Sheets for specific thermal information, via requirements, and recommended board layout. These documents are available at www.ti.com <<http://www.ti.com>>.
 - Laser cutting apertures with trapezoidal walls and also rounding corners will offer better paste release. Customers should contact their board assembly site for stencil design recommendations. Refer to IPC 7525 for stencil design considerations.
 - Customers should contact their board fabrication site for recommended solder mask tolerances and via tenting recommendations for vias placed in the thermal pad.

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LMH1208RTVR	Active	Production	WQFN (RTV) 32	1000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	L1208
LMH1208RTVR.A	Active	Production	WQFN (RTV) 32	1000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	L1208
LMH1208RTVR.B	Active	Production	WQFN (RTV) 32	1000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	L1208
LMH1208RTVT	Active	Production	WQFN (RTV) 32	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	L1208
LMH1208RTVT.A	Active	Production	WQFN (RTV) 32	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	L1208
LMH1208RTVT.B	Active	Production	WQFN (RTV) 32	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	L1208
LMH1208RTVTG4	Active	Production	WQFN (RTV) 32	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	L1208
LMH1208RTVTG4.A	Active	Production	WQFN (RTV) 32	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	L1208
LMH1208RTVTG4.B	Active	Production	WQFN (RTV) 32	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	L1208

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

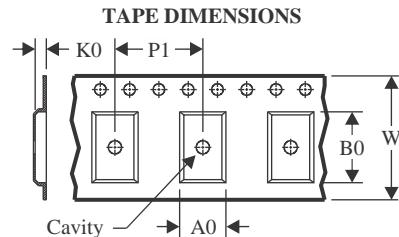
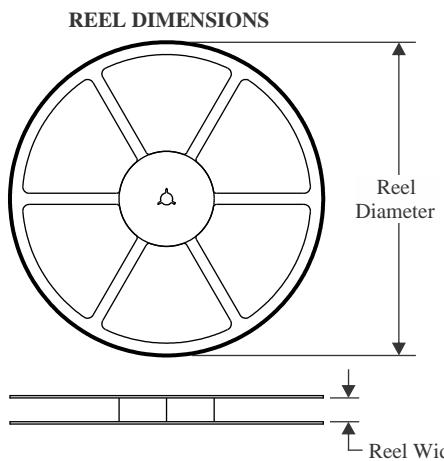
⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

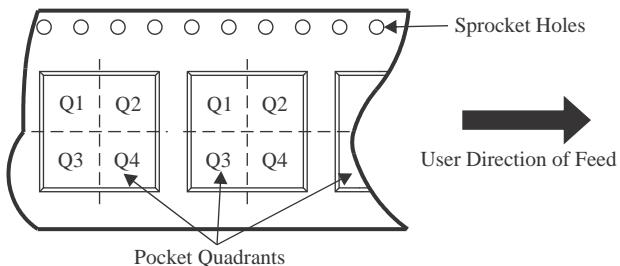
Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative

and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

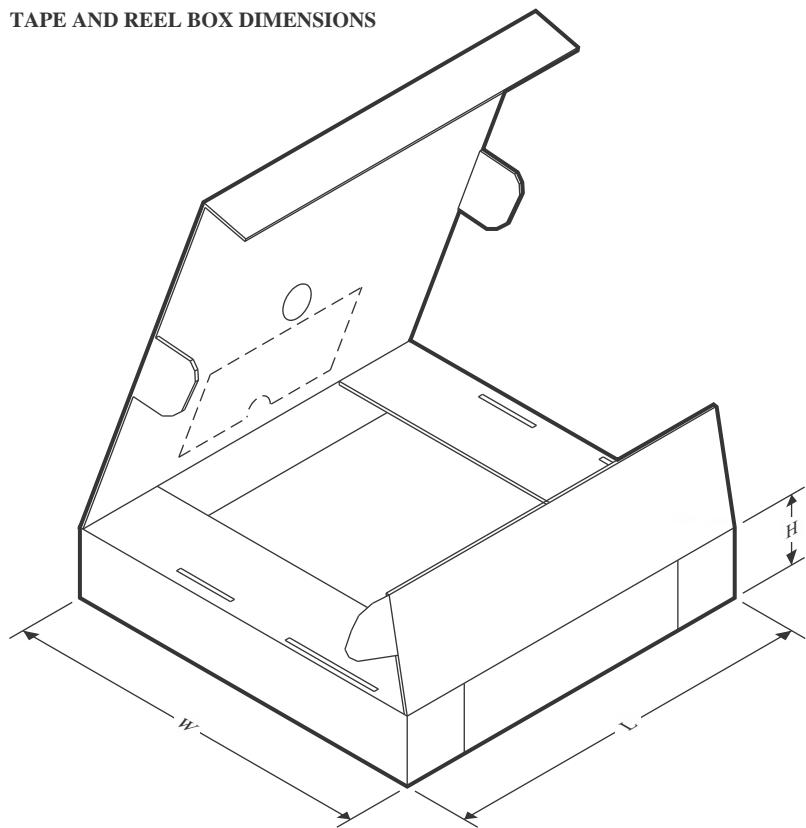
TAPE AND REEL INFORMATION

A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LMH1208RTVR	WQFN	RTV	32	1000	180.0	12.4	5.3	5.3	1.1	8.0	12.0	Q2
LMH1208RTVT	WQFN	RTV	32	250	180.0	12.4	5.3	5.3	1.1	8.0	12.0	Q2
LMH1208RTVTG4	WQFN	RTV	32	250	180.0	12.4	5.3	5.3	1.1	8.0	12.0	Q2

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LMH1208RTVR	WQFN	RTV	32	1000	182.0	182.0	20.0
LMH1208RTVT	WQFN	RTV	32	250	210.0	185.0	35.0
LMH1208RTVTG4	WQFN	RTV	32	250	210.0	185.0	35.0

重要なお知らせと免責事項

TIは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Webツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したもので、(1)お客様のアプリケーションに適したTI製品の選定、(2)お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3)お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されているTI製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TIはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TIや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TIおよびその代理人を完全に補償するものとし、TIは一切の責任を拒否します。

TIの製品は、[TIの販売条件](#)、[TIの総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#)またはTI製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TIがこれらのリソースを提供することは、適用されるTIの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TIがカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TIの製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TIはそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025年10月